



2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2020年11月13日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス

コード番号 6890 URL <http://www.ferrotec.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢

問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186

四半期報告書提出予定日 2020年11月13日 配当支払開始予定日 2020年12月9日

四半期決算補足説明資料作成の有無： 有

四半期決算説明会開催の有無： 有 (決算説明動画(録画)配信予定)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日～2020年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第2四半期	41,595	△0.6	3,913	9.7	2,824	14.3	70	△95.4
2020年3月期第2四半期	41,849	△7.5	3,566	△29.6	2,472	△49.2	1,539	△45.5

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 △169百万円(－%) 2020年3月期第2四半期 △630百万円(－%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期第2四半期	1.91	1.73
2020年3月期第2四半期	41.54	41.53

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2021年3月期第2四半期	217,690	71,829	24.1	1,409.34
2020年3月期	190,010	50,147	25.5	1,303.89

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 52,368百万円 2020年3月期 48,395百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年3月期	—	12.00	—	12.00	24.00
2021年3月期	—	12.00	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	—	—	12.00	24.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日～2021年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	85,000	4.1	6,500	8.1	5,500	29.0	1,500	△16.0	40.41

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無
新規 ー社 （社名）ー、除外 ー社 （社名）ー

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料10ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 （4）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- | | |
|----------------------|-----|
| ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| ② ①以外の会計方針の変更 | : 無 |
| ③ 会計上の見積りの変更 | : 無 |
| ④ 修正再表示 | : 無 |

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2021年3月期2Q	37,251,702株	2020年3月期	37,209,702株
② 期末自己株式数	2021年3月期2Q	93,568株	2020年3月期	93,568株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2021年3月期2Q	37,123,019株	2020年3月期2Q	37,066,521株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 （3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ開催を中止いたします。決算説明資料及び説明動画については、2020年11月30日に当社ホームページに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第2四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第2四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	8
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	10
(継続企業の前提に関する注記)	10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	10
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	10
(セグメント情報等)	11
(重要な後発事象)	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における経済状況は、米国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、中央銀行は景気対策として金融緩和を継続しております。中国経済は、新型コロナウイルス感染症の収束により、景気は回復に転じています。我が国では、同感染症の収束が未だに見えず商業活動に影響が出ており、今後の経済見通しは不透明な状況が続くものと考えられます。為替相場は、円高方向で推移いたしました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、半導体メモリや液晶・有機ELパネルなどの電子製品は、リモートワーク等の普及からパソコンやサーバーの需給が改善したため、デバイスメーカー各社の設備投資や設備稼働率は徐々に増加傾向となりました。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業におきましては、製造装置向けの部品販売や受託製造は回復の兆しが一層強くみられ、半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品の販売は前年を上回る水準となりました。

電子デバイス事業におきましては、主力のサーモモジュールは、世界各国の自動車販売の減少により温調シート向けが軟調な展開となりましたが、次世代通信システム5G関連機器向けが伸長し、PCR検査装置などの医療検査機器向けも堅調に推移しました。パワー半導体用基板は新型コロナウイルス感染症による市場低迷の影響もありましたが一定の水準で推移しました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は41,595百万円(前年同期比0.6%減)、営業利益は3,913百万円(前年同期比9.7%増)、経常利益は2,824百万円(前年同期比14.3%増)となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、第1四半期において製造設備の減損処理に伴い特別損失を計上したため、70百万円(前年同期比95.4%減)となりました。

当第2四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、次のとおりであります。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンウエーハ加工、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

主力の真空シールは、半導体および有機ELパネルなどの製造装置内に装着される機能部品です。半導体デバイスメーカーや有機ELパネルメーカー各社の設備投資は、順調な回復の兆しがみられました。また、半導体のウエーハプロセスに使用されるマテリアル製品(石英・セラミックス等)の販売は、リモートワーク等の拡大により、PCやサーバー用途の半導体製品の需要が回復し、デバイスメーカー各社の設備稼働率が上昇したため前年を上回る水準となりました。半導体製造装置、有機ELパネル製造装置などの部品洗浄サービスは堅調に推移しました。尚、同洗浄サービスを行う中国子会社は、科创板市場への上場準備に入ることを決定いたしました(8月14日公表の「中国子会社の科创板市場(スター・マーケット)への上場準備に関するお知らせ」をご参照下さい)。シリコンウエーハ加工は、概ね計画の水準で推移しましたが、これまでの設備投資の減価償却費用が先行しております。このため同製品を取扱う中国子会社の株式の一部を、中国地方政府系ファンドおよび民間の投資基金等へ譲渡することを決定いたしました(9月15日公表の「半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ」をご参照下さい)。

当該事業の製品は、半導体製造装置等の設備投資および設備稼働率に影響を受けます。

この結果、当該事業の売上高は28,784百万円(前年同期比5.9%増)、営業利益は2,177百万円(前年同期比18.8%減)となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体などです。

主力のサーモモジュールは、自動車温調シート向けが世界各国の自動車販売の減少により、軟調な展開が続きました。次世代5G用の移動通信システム機器向け、およびPCR等の医療検査装置向けは計画のとおり推移しました。パワー半導体用DCB基板は、新型コロナウイルス感染症の影響でやや調整局面となりましたが一定の水準を維持しております。車載向け等のAMB基板は、認定取得が順調に進んでおり、量産に向けた設備投資を開始しております。磁性流体は、スピーカー向けとスマートフォン用途の需要は一定水準で推移しました。

当該事業の製品は、景気に左右されにくい業種への販売を進めております。

この結果、当該事業の売上高は7,116百万円(前年同期比1.8%増)、営業利益は1,867百万円(前年同期比41.5%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

<資産>

当第2四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ27,680百万円増加し、217,690百万円となりました。これは主に現金及び預金11,171百万円、その他流動資産10,049百万円、受取手形及び売掛金2,700百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ5,998百万円増加し、145,860百万円となりました。これは主に社債(1年内償還予定を含む)1,184百万円の減少があった一方、その他流動負債501百万円、長期借入金(1年内返済予定を含む)6,138百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ21,681百万円増加し、71,829百万円となりました。これは主に為替換算調整勘定443百万円が減少した一方、非支配株主持分17,685百万円、資本剰余金4,643百万円の増加によるものであります。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ11,171百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には34,880百万円となりました。

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

<営業活動によるキャッシュ・フロー>

営業活動の結果得られた資金は5,529百万円(前年同期比4,596百万円増)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1,745百万円、減価償却費4,605百万円、その他4,540百万円によるものであります。支出の主な内訳は、売上債権の増加額3,853百万円、たな卸資産の増加額2,241百万円によるものであります。

<投資活動によるキャッシュ・フロー>

投資活動の結果使用した資金は9,966百万円(前年同期比9,262百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10,108百万円によるものであります。

<財務活動によるキャッシュ・フロー>

財務活動の結果得られた資金は15,874百万円(前年同期比965百万円増)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入9,488百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入11,354百万円によるものであります。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出5,614百万円、社債の償還による支出1,684百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2020年8月14日の「2021年3月期 第1四半期決算短信」で公表いたしました業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	23,709,139	34,880,888
受取手形及び売掛金	20,435,086	23,135,814
商品及び製品	6,046,893	5,445,599
仕掛品	4,459,132	5,563,382
原材料及び貯蔵品	6,763,152	8,119,011
その他	11,641,000	21,690,353
貸倒引当金	△1,602,762	△1,043,719
流動資産合計	71,451,642	97,791,329
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	27,346,105	26,251,872
機械装置及び運搬具(純額)	30,113,013	27,430,002
工具、器具及び備品(純額)	7,021,774	6,215,508
土地	1,891,733	1,891,061
リース資産(純額)	5,550,558	5,303,180
建設仮勘定	38,893,503	45,122,640
有形固定資産合計	110,816,688	112,214,266
無形固定資産		
のれん	25,521	—
その他	474,509	430,625
無形固定資産合計	500,031	430,625
投資その他の資産		
その他	7,288,199	7,803,538
貸倒引当金	△46,506	△549,325
投資その他の資産合計	7,241,692	7,254,213
固定資産合計	118,558,412	119,899,104
資産合計	190,010,054	217,690,434

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	18,251,741	17,091,089
短期借入金	12,510,147	11,597,015
1年内償還予定の社債	3,368,000	3,468,000
1年内返済予定の長期借入金	10,138,630	12,442,742
未払法人税等	586,948	1,036,038
賞与引当金	1,049,139	1,029,168
その他	15,538,776	16,040,336
流動負債合計	61,443,383	62,704,390
固定負債		
社債	19,282,000	17,998,000
転換社債型新株予約権付社債	3,734,976	3,734,976
長期借入金	29,439,887	33,274,678
退職給付に係る負債	649,603	635,989
役員退職慰労引当金	11,700	13,500
訴訟損失引当金	65,278	63,445
資産除去債務	139,543	140,038
その他	25,095,901	27,295,652
固定負債合計	78,418,891	83,156,280
負債合計	139,862,275	145,860,671
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,649,285	17,664,237
資本剰余金	18,547,939	23,191,410
利益剰余金	10,831,985	10,457,505
自己株式	△86,644	△86,644
株主資本合計	46,942,566	51,226,509
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	39,094	154,378
為替換算調整勘定	1,548,784	1,105,659
退職給付に係る調整累計額	△135,239	△118,029
その他の包括利益累計額合計	1,452,638	1,142,008
新株予約権	73,381	96,527
非支配株主持分	1,679,192	19,364,717
純資産合計	50,147,779	71,829,762
負債純資産合計	190,010,054	217,690,434

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
売上高	41,849,067	41,595,106
売上原価	27,941,107	27,496,596
売上総利益	13,907,960	14,098,509
販売費及び一般管理費	10,341,731	10,185,396
営業利益	3,566,228	3,913,113
営業外収益		
受取利息	47,525	22,252
補助金収入	358,983	417,470
持分法による投資利益	181,108	409,809
その他	198,494	203,869
営業外収益合計	786,111	1,053,402
営業外費用		
支払利息	540,359	768,421
為替差損	984,815	1,187,912
その他	354,739	185,347
営業外費用合計	1,879,914	2,141,682
経常利益	2,472,425	2,824,832
特別利益		
固定資産売却益	24,208	—
投資有価証券売却益	42,760	—
特別利益合計	66,968	—
特別損失		
固定資産処分損	12,450	—
減損損失	—	1,079,342
特別損失合計	12,450	1,079,342
税金等調整前四半期純利益	2,526,944	1,745,490
法人税等	1,080,689	1,556,634
四半期純利益	1,446,254	188,855
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	△93,433	117,941
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,539,687	70,913

(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益	1,446,254	188,855
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,921	113,398
為替換算調整勘定	△2,066,315	△471,540
退職給付に係る調整額	10,600	11,999
持分法適用会社に対する持分相当額	△19,228	△12,381
その他の包括利益合計	△2,076,865	△358,524
四半期包括利益	△630,610	△169,668
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△522,243	△239,716
非支配株主に係る四半期包括利益	△108,367	70,048

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	2,526,944	1,745,490
減価償却費	3,434,539	4,605,252
減損損失	—	1,079,342
のれん償却額	80,866	25,521
株式報酬費用	34,743	37,405
賞与引当金の増減額(△は減少)	379	2,295
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)	△8,400	1,800
貸倒引当金の増減額(△は減少)	462,691	△17,596
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△11,881	△13,559
受取利息及び受取配当金	△51,712	△26,772
支払利息	540,359	768,421
為替差損益(△は益)	404,660	714,673
持分法による投資損益(△は益)	△181,108	△409,809
固定資産処分損益(△は益)	△11,757	—
投資有価証券売却損益(△は益)	△42,760	—
売上債権の増減額(△は増加)	936,054	△3,853,300
たな卸資産の増減額(△は増加)	△2,131,197	△2,241,804
仕入債務の増減額(△は減少)	△2,767,988	66,297
その他	△1,122,841	4,540,848
小計	2,091,590	7,024,506
利息及び配当金の受取額	135,235	55,271
利息の支払額	△536,935	△704,683
法人税等の支払額	△756,645	△845,352
営業活動によるキャッシュ・フロー	933,245	5,529,740
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△19,057,029	△10,108,409
有形固定資産の売却による収入	17,759	171,010
無形固定資産の取得による支出	△66,081	△28,000
投資有価証券の取得による支出	△1,002	△730
投資有価証券の売却による収入	142,825	—
貸付けによる支出	△219,940	△306
貸付金の回収による収入	1,377	1,120
その他	△47,092	△1,515
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,229,185	△9,966,831

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額(△は減少)	2,757,453	1,682,418
長期借入れによる収入	6,636,909	9,488,319
長期借入金の返済による支出	△4,197,165	△5,614,668
リース債務の返済による支出	△118,727	△96,000
社債の発行による収入	11,154,219	492,710
社債の償還による支出	△979,000	△1,684,000
株式の発行による収入	33,833	—
非支配株主からの払込みによる収入	64,920	695,784
配当金の支払額	△443,098	△444,481
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	—	11,354,788
その他	—	△208
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,909,344	15,874,662
現金及び現金同等物に係る換算差額	△204,883	△265,822
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△3,591,478	11,171,748
現金及び現金同等物の期首残高	31,555,540	23,709,139
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	122,471	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	28,086,533	34,880,888

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第2四半期連結累計期間(自2019年4月1日至2019年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	27,182,121	6,991,181	34,173,302	7,675,764	41,849,067	—	41,849,067
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	245,497	—	245,497	—	245,497	△245,497	—
計	27,427,618	6,991,181	34,418,799	7,675,764	42,094,564	△245,497	41,849,067
セグメント利益	2,680,976	1,320,205	4,001,181	190,892	4,192,073	△625,844	3,566,228

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△625,844千円には、セグメント間取引の消去599,600千円、各報告セグメントに配分していない全社費用26,244千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第2四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	28,784,912	7,116,493	35,901,405	5,693,700	41,595,106	—	41,595,106
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	48,705	—	48,705	377,037	425,743	△425,743	—
計	28,833,617	7,116,493	35,950,111	6,070,738	42,020,849	△425,743	41,595,106
セグメント利益	2,177,407	1,867,757	4,045,164	344,846	4,390,010	△476,897	3,913,113

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額△476,897千円には、セグメント間取引の消去448,884千円、各報告セグメントに配分していない全社費用28,013千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「その他」セグメントにおいて1,079,342千円の減損損失を計上しております。

(重要な後発事象)

(子会社株式の一部譲渡)

当社は、2020年9月15日開催の取締役会において、当社の連結子会社である杭州中欣晶圓半導体股份有限公司(以下、「FTHW」という。)の当社及び他の連結子会社が保有する株式の一部を、中国の地方政府および民間の投資基金等へ譲渡することを決議し、2020年9月17日付で株式譲渡契約を締結し、2020年9月23日に譲渡が完了いたしました。

当該他の連結子会社の第2四半期決算日が2020年6月30日であるため、当該他の連結子会社が保有するFTHW株式の譲渡について重要な後発事象として記載しております。

(1)株式の譲渡の理由

当社は、中国政府の政策の恩恵を受けながら、今後の300mmの半導体ウェーハの増産に向けた資金調達の様相、当社グループの財務体質の改善、優秀な人材の確保を図るべく、様々な方を模索してまいりました。

その結果、FTHWの中国株式市場への上場を目指すことで、資金調達および人材面の経営課題を解決するとともに、上場に至る資本政策の過程において、FTHWの当社グループ持分の一部を地方政府および民間の投資基金等へ売却し、グループの財務体質の改善を図ることが、当社の企業価値向上に資すると判断いたしました。なお、上場日等の詳細は現時点では未定であり、中国の当局又は証券取引所による必要な承認を得られない可能性や、今後の準備過程における株式市況ならびに事業環境の変化やFTHWの資本提携先との協議の結果次第では、上場を行わないという結論に至る可能性もあります。

(2)株式譲渡の相手先の名称及び譲渡株式数

共青城興橙東櫻半導体産業投資合夥企業(有限合夥)	220,672,610株
銅陵市国有資本運営控股集团有限公司	88,269,044株
銅陵大江投資控股有限公司	88,269,044株
銅陵市建設投資控股有限責任公司	88,269,044株
長飛光纖光纜股份有限公司	220,672,610株
廈門建發新興産業股權投資式合夥企業(有限合夥)	74,410,804株
深圳鵬林楊投資合夥企業(有限合夥)	46,880,100株
嘉善嘉和股權投資合夥企業(有限合夥)	477,556,744株
嘉興臨智股權投資合夥企業(有限合夥)	177,548,763株
嘉興云初式投資管理合夥企業(有限合夥)	66,971,571株
嘉興安越投資合夥企業(有限合夥)	154,034,614株
福建省芯旺投資合夥企業(有限合夥)	36,445,052株

(3)株式譲渡の時期

2020年9月23日

(4)当該子会社の概要

子会社の名称	杭州中欣晶圓半導体股份有限公司
事業内容	半導体ウェーハの製造、販売

(5)譲渡株式数・出資比率、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

譲渡前の所有株式数	2,900,000,000株(議決権所有割合:100%)
うち当社所有株式数	1,305,000,000株
うち連結子会社所有株式数	1,595,000,000株
譲渡株式数	1,740,000,000株
うち当社譲渡株式数	1,305,000,000株
うち連結子会社譲渡株式数	435,000,000株
譲渡価額	1,971,246千人民元
うち当社譲渡価額	1,478,434千人民元
うち連結子会社譲渡価額	492,811千人民元
譲渡後の所有株式数	1,160,000,000株(議決権所有割合:40%)
うち当社所有株式数	一株
うち連結子会社所有株式数	1,160,000,000株

(6)実施する会計処理の概要

「企業結合会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引等として、売却した株式に対応する持分を当社グループの持分から減額し、非支配株主持分を増額させるとともに、売却による当社グループ持分の減少額と売却価額との間に生じた差額を、資本剰余金とする処理を行う予定です。

(連結子会社の第三者割当増資)

当社は、2020年10月16日開催の取締役会において、当社の連結子会社である杭州中欣晶圓半導体股份有限公司(以下、「FTHW」という。)が第三者割当増資を行うことを決議しました。決議した発行価額の総額のうち、2020年10月31日までに1,205,750千人民元の払込みが完了し、残額については現在交渉しております。

(1)増資の目的

当社は、顧客の工場立ち上げにあわせて半導体ウェーハの量産化体制を早期に構築する必要がありますが、現状の生産キャパシティでは将来的に顧客の需要に対応できない可能性が出てきております。そのため、事業機会の逸失を防ぎつつ、今後の設備投資に機動的に対応するには、一定のキャッシュポジションを確保することが必要ですが、巨額の設備投資を要する半導体ウェーハ事業では、当社グループの財務への影響を鑑み、新たな設備投資については外部資金を導入することをグループ方針としておりました。今般、中国の半導体装置メーカーおよび投資ファンド等よりFTHWの第三者割当増資に応じたいとの申し出があったことから、当社内で精査した結果、当社の企業価値向上に資すると判断し、今回の決議に至りました。なお、本件後、当社グループのFTHWへの出資比率が40%を下回りますので、連結子会社から持分法適用の関連会社となる予定です。当該影響については、現在精査中であります。

(2)当該子会社の概要

子会社の名称	杭州中欣晶圓半導体股份有限公司
事業内容	半導体ウェーハの製造、販売

(3)第三者割当増資の概要

- | | |
|----------------|--------------------------|
| ①発行する株式の種類および数 | 普通株式 1,032,256,776株 |
| ②発行価額 | 1株につき1.55人民元 |
| ③発行価額の総額 | 1,599,998千人民元 |
| ④払込期日 | 2020年10月31日 |
| ⑤割当先 | 杭州国改立春股権投資合夥企業(有限合夥)他17社 |

第三者割当増資の引受先に対して、当社代表取締役社長及び重要な子会社の役員が出資しており関連当事者取引に該当します。